

北京君正集成电路股份有限公司

关于公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

根据工业和信息化部产业发展促进中心下发的《关于“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项 2018 年课题立项的通知》（产发函[2018]963 号）文件，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月申报的“面向智能终端的嵌入式高能效深度学习引擎开发与产业化”课题项目获得立项批复，并作为牵头承担单位联合清华大学、东南大学共同承担“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”项目。该项目期限为 2018 年 1 月至 2020 年 12 月，项目经费按年度分别下拨。2020 年 6 月 19 日公司收到工业和信息化部产业发展促进中心拨付的第三笔项目经费 1,848 万元，其中 929.9 万元为我公司的承担项目经费。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

目前该项目公司获得政府补助资金 929.9 万元，属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量及对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的规定，上述项目资金属于与公司日常活动相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认其他收益计入当期损益。

该项目执行期为自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司将自收到项

目补助资金当月起至项目结束日分期结转入其他收益，预计将会增加公司 2020 年度利润约 929.9 万元。

三、风险提示和其他说明

1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；

2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、有关补助的政府公示文件
- 2、收款凭证等

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十二日